



品番 PRODUCT No.	A	B	C
SMD25-26WS	35.56	30.48	12.7
SMD25-28WS	38.10	33.02	10.2
SMD25-30WS	40.64	35.56	12.7

④						②	黄銅 Brass	△△ 半田鍍金又は錫鍍金 Solder Plating or Tin Plating
③						①	ナイロン66 (GFA) NYLON66 (GF)	UL94 V-0
△	04.12.8	半田メッキ削除 Solder Plating deletion.	N. Y. H.	SMD25-□□WS				
△	03.2.20	角ピンメッキ追加 Pin Plating addition.	K. K. Y. H.	製品番号 PRODUCT No.	No.		材 料 MATERIAL	備 考 NOTE
記号 No.	年月日 DATE	変更記事 REVISION RECORD	設計承認 DESIGN APP			製品名 NAME	SMDウエハー (ストレート型) SMD WAFER (S-Type)	
承認 APPROVED	確認 CHECKED		一般公差 TOLERANCE	尺度 SCALE	図番 DRAWING No.			
K. Shiine	Y. Horiuchi		±0.3	2/1	JC-0807-10E			
設計 DESIGN	製図 DRAWING		JAPAN AUTOMATIC MACHINE CO., LTD.					
K. Kusano	K. Kusano							